## ()707 信息披露

## 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

以各境示: 东大会召开日期:2024年5月17日 次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开会议的基本情况 股东大会类型和届次

(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人,董事会
(二) 股东大会召集人,董事会
(三) 投票方式,本水股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
(四) 现场会议召开的日期 时间和地点
召开日期时间; 2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分
召开地点; 江苏省昆山市千灯镇中庄路 209 号江苏艾森半导体材料股份有限公司五楼会议室
(五) 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票总止时间; 自 2024 年 5 月 17 日
至 2024 年 5 月 17 日

序号	议案名称	投票股东类型
17-5	以来石桥	A股股东
非累积投	票议案	•
1	关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案	V
2	关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案	V
3	关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案	V
4	关于《江苏艾森半导体材料股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案	V
5	关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案	$\checkmark$
6.00	逐项审议关于确认公司董事 2023 年度薪酬/津贴发放及 2024 年度薪酬/津贴方案的议案	V
6.01	关于确认公司非独立董事 2023 年度薪酬发放及 2024 年度薪酬方案的议案	$\checkmark$
6.02	关于确认公司独立董事 2023 年度津贴发放及 2024 年度津贴方案的议案	V
7	关于确认公司监事 2023 年度薪酬发放及 2024 年度薪酬方案的议案	$\checkmark$
8	关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案	V
9.00	逐项审议关于修订部分公司内部治理制度并制订部分新增内部治理制度 的议案	V
9.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	V
9.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	V
9.03	关于修订《监事会议事规则》的议案	V
9.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案	V
9.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	V
9.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案	V
9.07	关于修订《关联交易管理制度》的议案	V
9.08	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	V
9.09	关于修订《募集资金管理制度》的议案	V
9.10	关于修订《信息披露管理制度》的议案	V

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址,vote.secinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台的站员明。 (二)同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果 步雄 为准。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

。会议出席对家 ) 殷权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

17752391	放现代码
股	688720
(二)公司董事、监事和	中高级管理人员。

(二) 公司惠守, 通守和尚故官建入识。 (三) 公司嗣請的律师。 (四) 其他人员 五, 会议登记方法 (一)登记时间: 2024年5月16日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30 (二)登记时点: 江苏省昆山市千灯镇中庄路 299号江苏艾森半导体材料股份有限公司证券事务

(二) 登记地点:江苏省昆山市千灯镇中庄路 299 号江苏艾森半导体材料股份有限公司证券事务 部。
(三) 登记方式
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、邮件的方式办理登记。
1、法从股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印作(加盖公章)、本人有效身份证明原件和法人股东账户卡办理登记:由法定代表人委托代理人出席会议的、代理人应持营业执照复印作(加盖公章)、本人有效身份证件原件、法定代表人依法出具的投权委托书附件1)和法人股东账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席会议的、应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记;委托代理人出席会议的、代理人应持者也有效身份证件原件。自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书(附件1)和股东账户卡办理登记。
3、股东可按以上要求以信函和邮件的方式进行登记、信函到达或邮件到达时间应不迟于 2024 年5 月 16 日 16 30、信函、邮件中需注明股东联系人、熊系电话及注明"股东长"字样、公司不接受电话方式办理登记。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
大、其他事项
(一)联系方式。
联系地址:江苏省昆山市千灯镇中庄路 299 号江苏艾森半导体材料股份有限公司证券事务部邮政编码。215341
联系人、徐雯

邮箱:ir@asem.en (二) 出席现场会议的人员需于会议开始前半小时到达会议地点,出示能够证明其身份的相关证明文件,验证人场办理签到。 (三)出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

(三) 出席会以的取页3%(1~5%) 转比公告。 江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会 2024年4月27日 附件1.授权委托书 附件1.授权委托书

附针: 按权委托书 按权委托书 江苏艾森半导体材料股份有限公司: 运委托、先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 17 日召开的贵公司 2023 年年度 股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人特许优先股款: 委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案			
2	关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案			
3	关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案			
4	关于《江苏艾森半导体材料股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的 议案			
5	关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案			
6.00	逐项审议关于确认公司董事 2023 年度薪酬/津贴发放及 2024 年度薪酬/ 津贴方案的议案			
6.01	关于确认公司非独立董事 2023 年度薪酬发放及 2024 年度薪酬方案的 议案			
6.02	关于确认公司独立董事 2023 年度津贴发放及 2024 年度津贴方案的议案			
7	关于确认公司监事 2023 年度薪酬发放及 2024 年度薪酬方案的议案			
8	关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案			
9.00	逐项审议关于修订部分公司内部治理制度并制订部分新增内部治理制度的议案			
9.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
9.02	关于修订《董事会议事规则》的议案			
9.03	关于修订《监事会议事规则》的议案			
9.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
9.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
9.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
9.07	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
9.08	关于修订《累积投票制实施细则》的议案			
9.09	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
9.10	关于修订《信息披露管理制度》的议案			
9.11	关于制订(会计师事务所洗聘制度)的议案			

受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文、为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划、投资者应当到\*www.sec.com.cn 网站行细阅读年度报告全文。
2 重大风险提示 报告期内、不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险。敬请愈阅"第三节管理是讨论与分析"四、风险因素"部分内容。
3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在度则遗裁、误争性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
4 公司全体董事出席董事会会议。

公司上的集中口所重事会会议。 上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 V否

□ 1.5 元(含稅)。截至 2024年 4 )
□ 1.5 元(含稅)。
□ 1.5 元(公稅)。
□ 1.5 元(公尺)。
□ 1.5 元(

公司股票简况							
股票种类	股票上市	交易所及板块	科帥版 艾森股份 <b>688720</b> / ,		票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券	交易所科创板			/		
公司存托 □适用 联系人和	√不适用	I					
联系人和联系方式	t	董事会秘书(信息披露境	内代表)		证券事务代表		
姓名		陈小华			徐雯		
办公地址		江苏省昆山市千灯镇中区	主路 299 号		江苏省昆山市干灯镇	中庄路 299 号	
电话		0512-50103288			0512-50103288		

| 电子信箱 | 16号asem.cm | 16号asem.cm | 2 报告期公司主要业务高介 (一)主要业务主要产品或服务情况 1.主要业务基本情况 | 公司主要业务基本情况 | 公司主要从事电子化学品的研发、生产和销售业务。公司围绕电子电镀、光刻两个半导体制造及 | 対表过程中的关键工艺环节、形成了电镀液及重度试剂、光刻胶及配套试剂两大产品板块不同,产品产品产品中毒。由来由或由效 第2月由 え会化 月里一点一般 \$3. \$2.45 ET PU 大碟 L 乙环 P. PU 以 电镀液 及配套试剂 光刻胶 反配套试剂两大产品 板块 布局 上 广泛应用于集成电路,新型电子元件及显示面板等行业。依托自身配方设计、工艺制备 及应用技术等 核心技术,公司能够为客户提供关键工艺环节的整体解决方案 (Tumkey),满足客户对电子化学品的特定功能性要求。

核心较水、公司能够为各户强限大键上之外自的途体等决分录(Turnkey),两定各户对电子化学品的特定功能性要求。 2.主要产品基本情况 公司自成立以来、紧抓产业历史机遇,通过持续自主研究开发,不断在关键半导体材料上实现突 破。公司以半导体持续封装的电镀产品起步,逐步掌握了引脚表面处理的全套电子化学品,具体包括 电镀液和电镀前后处理化学品。经过多年努力,公司逐步取代国外材料公司成为传统封装电镀化学品。 领域的国内主力供应商,并逐步向先进封装,晶圆制造及显示面板等领域延伸,形成了电镀液及配套 试剂,光刻胶及配套试剂两大业务板块。 (1)电镀液及配套试剂 ①电镀液

①电镀液 电镀液是半导体制造过程中的核心材料之一,由主盐、导电剂,络合剂及各类电镀添加剂组成,其 中电镀添加剂是影响电镀功能的核心组分。传统封装领域,公司的电镀液产品主要应用于芯片引脚表 面镀锡,主要为基于甲基糖酸的电镀体素,系通过电化学方法在集成电路或电子元件引脚表面沉积一 层均匀,致密的纯锡镀层,利用锡导电性好,易针焊的特性实现集成电路、电子元件与印刷电路板之间 与454年4年2年16日44464

及开形所接和导电性能。 在性转射接产品的基础上,报告期内公司电镀液产品逐步向外资厂商垄断的先进封接及晶圆制 造领域处性,随着集成电路中互连层数、先进封装中对 RDL 和铜柱结构使用的增加,粮互连针针装 将持续增长。公司的先进封装电镀产品主要用于先进封装 Bumping 工艺凸块的制作,可以实现芯片与 晶圆、载板之间的电气连接。 ②电镀斯处理化学品

集成电路或电子元件在进入电镀液以前的加工处理和清理工序总称为电镀前处理(或预处理)。

针对电镀前处理各工艺步骤,公司提供的电镀前处理化学品包括祛毛刺液、除油剂、去氧化剂、活化剂、化物液等。
③电镀后处理化学品
集成成整或电子元件在电镀后的加工处理和清理工序总称为电镀后处理。电镀后处理化学品主要有两类用途,一类用于对电镀高量及上残留的镀层进行退镀,以提高电镀效率。针对电镀后处理各工艺步骤、公司提供的电镀后处理化学品包括中和剂、退镀剂等。
(2)光细胶及度重试剂
①光细胶 根据应用领域、光刻胶可分为 PCB 光刻胶、显示面板光刻胶和集成电路光刻胶(可进一步细分为 先进封装和温圆制造),其技术整全依次提升。国际光刻胶及用起步较晚,与国外先进光刻胶技术相比,国内产品仍有较大差距,目前主要集中在 PCB 光刻胶 及居巴克斯氏处等后,国内集成电路光刻胶及 ULED 显示面板光刻胶等产品,国内集成电路光刻胶及 ULED 显示面板光刻 等产品,国内集成电路光刻度及 ULED 显示面板光刻度 等并色工艺光刻胶为实破口,覆盖晶圆制造、先进封装及显示面板等应用领域、成功打破国外垄断,并逐步向全进制程延伸。

破口、覆盖显圆制造、先进封装及显示面板等应用领域,成功打破国外垄断,并逐步向先进制程延伸。 ②光频胶配套试剂 公司光刻胶配套试剂主要应用于先进封装领域。先进封装要求在晶圆划片前融入封装工艺步骤, 具体包括晶圆研磨解化、线路重排(RDL)、凸块制作(Bumping)及三维柱通孔(TSV)等工艺技术、涉及 与晶圆制造相似的涂胶、显影、去胶、独则等工序步骤。报告期内、公司应用于无进封装领域光刻胶配 套试剂已经实现批量供应、主要产品包括附着力促进剂、显影液、蚀刻液、去除剂等。 (3)电镀配套材料 除电子化学品外、公司还可以提供电镀工艺配套的锡球、镍饼等阳极金属材料及阳极袋、退镀用 胶条等辅权、以满足客户的整体需求。公司销售的锡球主要采用外协加工模式。 (4)其他电子化学品主要为感光油墨。感光油墨对紫外线敏感,并且能通过紫外线固化,主要用于 PCB 电子线移板自动化生产制造中的文字打印等。 (二)主要经营模式

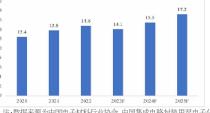
格。
3.生产模式
公司主要按照以销宅产的总体原则安排生产计划,分为按计划生产和按需生产两种生产模式。公司主要按照以销宅产的总体原则安排生产计划,分为按计划生产的按需生产产能力,制定生产计划。计划人员会根据近三个月的销售情况与销售部门确认后制定生产计划。股情况下公司制定的生产计划的能够满足客户的定期下单需求。按需生产的模式,是指在客户临时加单的情况下,公司根据临14.研发模式。4.研发模式。公司研发流程主要包括以下过程:(1.研发立项的设施程主要包括以下过程:(1.研发立项的设施程主要包括以下过程:(1.研发立项的设施程主要包括以下过程:(1.研发立项的设施程主要包括以下过程:(1.研发立项的设备程度,1.1分比例,1.1分

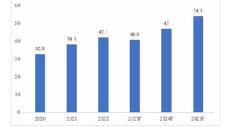
公司财及就程主要包括从下过程:
(11研发证据主要包括从下过程:
(11研发证期)投近期的设计划,以对研发项目实施总体规划。研发项目因市场调研情况及产品规划开立课题由各产品事业部或研发部负责人收集信息、分析需求、并出具相关的需求报告、经研发总监或总经理申核通过后提交管理是会议审议、审议通过后进行相应的项目立项。项目通过可行性评估后,签发研发任务给到研发部。研发部负责人确定项目负责人、研发任务转化为研发计划。
(2)研发需求确认的设理,可自负责人根据研发计划的规划,确定研发的需求,主要包括以下内容。(2)产品的主要性能指标、主要来源于应用需求;(2)法律法规及国家相关强制性标准;(3)历史类似研发项目积累的适用信息;(4)新产品安全性知适用性至关重要的特性要求,如安全、包装、运输、贮存、环境、卫生等。
(3)产品设计及实验室小场阶段
项目负责人根据研发需求,在实验室内组织开展配方设计及测试评估工作,并根据测试结果优化调整配方。

调整尼方。
(4)样品试制及研发验证阶段
研发部组织有关部门评审研发项目的阶段性结果。研发部负责人负责审核样品试制技术要求,并 格准试制样品。试制完成的样品由研发部安排进行产品性能验证,样品检验合格的进入下一研发阶段。如不合格。研发部门分析技术原因,并重新活制成变更配方设计。 段、如不合格。研发部门分析技术原因,并重新活制成变更配方设计。 步确保产品能够满足客户的使用及预期用途要求,公司送样至客户现场,使用客户的产线资源对 发生进步的运 样品进行验证。 (5)中试及产品认证阶段

(3) 中以及广流从即6段 研发部门完成工艺标准和控制标准的制定,并根据研发验证结果持续优化和调整产品,直至研发成果通过客户实际产线测试,完成最终产品从证。 (三) 所处行业情况 1. 行业的发展所段,基本特点,主要技术门槛

(二) 所处行业情况
1. 行业的发展阶段 基本特点、主要技术门槛
(1)公司所处行业
(1)公司所处行业
公司主要从事电子化学品的研发、生产和销售业务。公司围绕电子电镀、光刻两个半导体制造及
封装过程中的关键工艺环节,形成了电镜液及配套试剂、光刻散及配套试剂两大产品板块布局。产品
广泛应用于集成电路、显示面板及新型电子元器件等行业。按照行业的一般分类标准,公司所处行业
为半导体材料行业。
(2)行业的发展阶段及细分领域市场情况
(0)集成电路温电子化学品
根据中国电子化学品
根据中国电子化学品
根据中国电子化学品
根据中国电子化学品
使用。全球在集成电路、显示面板、光伏三个应用领域所使用湿化
学品量的比例约为 46%、36%及 18%、集成电路是湿化学品的主要应用领域、全球湿化学品需求增长
的主要驱动力来源于对集成电路持续增加的需求及多略晶圆一的键成投产。
国内退化学品行业产业费自杜州、强度发展的同时、也存在善部分瓶颈。湿化学品行
业投资大,产品求认证过程繁琐,期期长、生产商需长期投入,持续研发、还需配备高素相从业人员。国
产温化学品上国州水支企业美国杜州、强度国 ASSF 等相比、在高端于急性能及规度上的有效大差的,最
定在多个品种均拥有较高市占率的龙头企业、特别是在集成电路封装温电子化学品市场。根据中国
全不分品种均拥有较高市占率的龙头企业、特别是在集成电路封装温电子化学品市场。根据中国
电子材料行业协会的数据,2022 年中国集成电路封线与先进身线,用湿化学品市场,根据中国
电子材料行业协会的数据,2022 年中国集成电路对线与先进身线,用湿化学品市场,根据中国
电子材料行业协会的数据,2022 年中国集成电路对表生产量分别。有时是优全品市场规模
14.8 亿元,同比 2021 年的 13.8 亿元增长了 2.5%。随着品图制造工艺的不断提升,对与卫起车的封测技术同步骤水量低度格量,在增加,预计 2025 年中国集成电路封装用混化学品市场规模将达到 17.2 亿元。
图:中国集成电路封装用混化学品市场规模/单位·亿元)





单位:亿5						
项目	2020	2021	2022	2023F	2024F	2025F
前道工艺	32.8	38.3	42.1	40.9	47.0	54.1
后道工艺	12.4	13.8	14.8	14.1	15.5	17.2
合计	45.2	52.1	56.9	55.0	62.5	71.3
集成电路 导体电镀化学	电镀材料细分品市场规模预	市场方面,根据 计为9.92 亿美	市场研究机构 元,而 2024 年到	TECHCET 发布 近计达到 10.47 (	的预测数据,2 乙美元,预计增	023 年全球半速为 5.6%,主

。由于2021年中期1129/088701779/92/七美元。而2024年预计达到10.47亿美元。预计增速为5.666。主要增长30力包括集成电路中互连层的增加、先进封装中对1001年间已按600年的。由于继续沿用大马士车工艺镇铜布线、先进工艺节点逻辑器件对铜互连材料需求的持续增长。铜互连材料是晶圆制造及先进封装电镀材料最大的细分市场。2021-2026年复合年化增长率预计为8.6%。 及允进封装电骤杯针破大的3出灯印刷,2021-2020 十至 日下12日 人。 ②光划胶市场概况 《光刻胶是技术壁垒最高的电子化学品之一。我国光刻胶产业、特别是集成电路用光刻胶、长期以 来发积较为缓慢。2008 年以后,在国家重大科技专项的支持和国内集成中路产业快速成长的带动下, 这种局面得到了一定程度的改变,陆续有公司关注集成电路用光刻胶及其相关。启产业化技术开发, 并有部分产品进入市场应用。但是,目前国内光刻胶仍主要集中在 PCB 光刻胶 TPT-LCD 光刻胶等产 日本在 OLED 显示面版和集成电路用光刻胶等高端产品仍需大量进口,国产光刻胶正处于由中低端向

中高端过渡阶段。 接曝光光漏波长划分,光刻胶可分为g线光刻胶(436nm),i线光刻胶(365nm),KrF光刻胶 (248nm),ArF光刻胶(193nm)和 EUV 光刻胶(13.5nm)。根据中国电子材料行业协会的数据,当前我国 g/线光测胶的国产化率约为 20%,仍处于较低水平,KrF光刻胶整体国产化率不足 2%,ArF光刻胶整 作国金化安定 167

(248mm).Arf 元类WKC147mm/n.c.

前线光刻版的国产化率约为 20%,仍处于较低水平,Krf 光刻收验14年10 几十一个。

体国产化率不足 1%,

根据中国电子材料行业协会的数据,2022 年中国集成电路 gi 线光刻胶市场规模总计 9.14 亿元,

预计到 2025 年将增长至 10.09 亿元,其中,2022 年中国集成电路 gi 线光刻胶市场规模 5.47 亿元,预计 2025 年将增长至 5.95 亿元。根据中国电子材料行业协会的数据,中国集成电路用 gi 线光刻胶的具体市场规模如下:

单位:亿元

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023F | 2024F | 2024F | 2025F | 2025F | 2026F | 2025F | 2026F | 2025F | 2026F | 2025F | 2026F | 2026F

<b> </b>	2020	2021	2022	2023F	2024F	2025F
品圆制造用 g/i 线光刻胶	2.63	3.19	3.67	3.48	3.76	4.14
対装用g/i 线光刻胶	4.42	4.95	5.47	5.25	5.51	5.95
分计	7.05	8.14	9.14	8.73	9.27	10.09
FT-LCD 光刻胶的需求快速增长	.CD 面板产 。与此同时	,多条 OLEI	D 产线的规:	训与投产也	将带动相关	使得大陆 领域对光
2的需求增长。由于显示面板涂	布面积大,	显示面板用:	光刻胶用量	及市场规模	大于集成电	路市场。
左 DCDI(北京原鉄正形) 上五	DCDI E #	型用 _£ ₩Ⅱ	百水水泥 胆	ユコムショルた日	17日A由+	**: 田工

20 世紀 70 年代以前 通孔插接靶封装 (SP)等 20 世 纪 80 表面贴装型封装 郑科与1线片式载体封装(PLCC),郑科巴边1线扁平封装(PQFP),小外形表面封装(SOP,年代以后 多芯片组封装 (MCM) 多层陶瓷基板(MCM-C)、多层薄膜基板(MCM-D)、多层印制板(MCM-L)

晶圆级系统封装-硅通孔(TSV)、扇出型集成电路封装(Fan-Out)、三维立体封装(3D)等 尽管近几年来国内领先封装企业通过自主研发和收购兼并等方式逐步掌握第三、四、五阶段的部分先进封装技术,但技术发展先于市场,国内封装行业整体发展水平与境外仍存在一定的差距,主流封装产品已覆盖至第四阶段。公司能够提供的不同封装技术产品具体如下: 电镀液及配套试剂(传统 批量供应 財法) 第二阶段 - 譲液及配套试剂(传统 第三阶段 QFN 等 批量供应

芝环节类似晶圆制造,是集成电路制造的重要发展方向 进一步朝向小型化与多功能的发展、集成电路尺寸越来越小、集成电路杆类越来越 接口密度不断提升、先进封装技术成为未来集成电路制造的重要发展方向。先进封 接、在同一个封装内集成不同材料、线宽的半导体集成电路和器件等方式提升集成

第四、第五阶段

装技术通过优化连接,在同一个封装内集成不同材料,线宽即牛亨体集成电给中面IT可以从底户本地电路的连接密度和集成度。 电路的连接密度和集成度。 根据 Yole 的数据,预计 2028 年先进封装全球市场规模约 786 亿美元,占比约 54.8%。2022 年至 2028 年,相比同期全球整体封装市场(年复合增长率约为 7.1%),全球先进封装市场的年复合增长率 约为 10%,尤进封装市场的增长更为显著,将成为全球封装市场的主要增量。 (3)行业基本特点及主要技术门槛 (3)行业基本特点及主要技术门槛 人国家政策与产业资本支持力度大 公司所属半导体材料行业为国家重点支持和威励发展的行业。目前,国务院,国家发改委,工信 都,商务部以及科技部等多个机构和部门均通过各类纲领性文件,政策性文件、发展规划以及指导性 文件等在多层水。多方面,多角度对半导体材料全产业链给予了大力支持,为半导体材料行业提供了 有力的总量、专项的以及科技部等

要依靠进口。根据中国电子材料行业协会的数据。2021年国内集成电路用i/g线光刻胶国产化率 20% 左右, Krt 光刻胶固产化率不足 2%, Art 光刻胶固产化率低于 1%, 核心技术难题急需尽快突破。目前 我国正急需解决半导体材料领域核心技术的"卡脖子"问题,湿化学品及光刻胶领域国产化趋势拓展 出了巨大的市场空间。

出了巨大的市场空间。 D客户认证周期较长 公司客户所处的集成电路、电子元件及显示面板行业对电子化学品等材料供应商的产品质量和 供货能力十分重视。产品通常需要经过客户的严格认证。电子化学品行业认证周期较长、新产品从研 发到正式投入产业化需要经历相当长的时间,需要通过客户长期的严格认证。 ②主要技术厂施

/腦。 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况 在功能湿化学品及光刻胶领域,国外企业的优势明显,先进封装用电镀化学品及光刻胶产品中国 企业更是占据的市场主导地位,全球主要供应商均为国际公司,包括美国杜邦、日本 JSR、日本 《施国 March

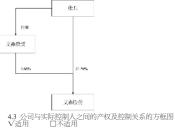
	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年
总资产	1,279,889,093.54	562,255,979.00	127.63	535,610,423.23
归属于上市公司股东的净 资产	1,016,246,943.63	441,186,438.38	130.34	421,757,569.38
营业收入	360,039,281.45	323,766,288.78	11.20	314,478,827.55
归属于上市公司股东的净 利润	32,657,327.71	23,284,746.48	40.25	34,990,369.49
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	27,164,699.66	14,403,274.36	88.60	29,605,072.12
经营活动产生的现金流量 净额	-84,531,832.72	-48,497,230.55	不适用	-108,625,591.28
加权平均净资产收益率 (%)	7.17	5.37	增加 1.80 个百分点	10.52
基本每股收益(元/股)	0.49	0.35	40.00	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.35	40.00	0.55
研发投入占营业收入的比例(%)	9.08	7.32	增加 1.76 个百分点	7.47

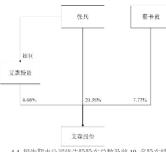
3.4 1Kロ州7学度的王安会计 単位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 71,666,840.38 82,361,977.11 3,902,575.16 112,107,888.80 日属于上市公司股东的净利 3,537,777.14 7,580,832.82 ,417,949.17 14,120,768.58 3属于上市公司股东的扣除 | 经常性损益后的净利润 7,497,182.92 3,411,338.40 7,033,626.32 9,222,552.02 A.营活动产生的现金流量净 -26,640,915.63 -26,101,206.93 16,815,550.02 -14,974,160.14

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 □适用  $\sqrt{\text{不适用}}$  4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10

截至报告期末晋迪股股东忌数(尸)				9,745					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)				9,890					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				/					
年度报告披露日前。	上一月末表决权的	恢复的优先股股东。	总数(户)	/					
截至报告期末持有特	特别表决权股份的	勺股东总数(户)		/					
年度报告披露日前 (户)	上一月末持有紫	<b>特别表决权股份的</b>	股东总数	/					
前十名股东持股情况	2								
股东名称	报告期内增减	期末持股数量	H:(例(%)	持有有限售条件	包含转融通借出股份的限售股份	质押、 冻结情况	乐记或 兄	股东性质	
(全称)	权古州内增减	州木村双致重	[E]V(%)	股份数量	数量	股份 状态	数量		
张兵	0	19,031,621	21.59	19,031,621	19,031,621	无	0	境内自然 人	
蔡卡敦	0	6,847,826	7.77	6,847,826	6,847,826	无	0	境内自然 人	
昆山艾森投资管理 企业(有限合伙)	0	5,869,565	6.66	5,869,565	5,869,565	无	0	其他	
昆山世华管理咨询 合伙企业(有限合 伙)	0	5,335,968	6.05	5,335,968	5,335,968	无	0	其他	
北京芯动能投资基 金(有限合伙)	0	4,398,164	4.99	4,398,164	4,398,164	无	0	其他	
天津宸辉投资管理 有限公司-天津和 谐海河股权投资合 伙企业(有限合伙)	0	4,066,418	4.61	4,066,418	4,066,418	无	0	其他	
鹏鼎控股(深圳)股 份有限公司	0	2,600,000	2.95	2,600,000	2,600,000	无	0	境内非国 有法人	
华泰证券资管-宁 波银行-华泰艾森 股份家园1号科创 板员工持股集合资 产管理计划	2,161,969	2,161,969	2.45	2,161,969	2,161,969	无	0	其他	
中国建设银行股份 有限公司-南方信 息创新混合型证券 投资基金	1,936,886	1,936,886	2.20	165	165	无	0	其他	
庄建华	0	1,636,364	1.86	1,636,364	1,636,364	无	0	境内自然	

□适用 √不适用 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表 





## :688720 证券简称:艾森股份 公告编号:2024-034 江苏艾森半导体材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

督及评估內外部审计工作和内部挖制。公司董事会同意通过(关于公司董事会审计委员会 2023 年度 履职情况报告的议案)。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
县体内答注单公司同日按案于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(江苏艾森半导体材料股份有限公司023 年度事余申计委员会履职情况报告)。
表决结果。9 名董事同意。0 名董事反对。0 名董事弃权。
(四)申议通过了《关于会计师事务所的履职情况评估报告的议案)
董事会认为,根据(国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(上海证券交易所科创板上市公司目律监管者引第1号一规范定作)等相关法律法规以及公司章程》的相关规定,公司对上会会计师事务所得非遇通价收,2023 年度金的履规情况进行报告的议案)。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
其体内答详见公司同日按第于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(江苏艾森半导体材料股份有限公司关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告)。公司董事会同意通过(关于会计师事务所的履职情况评估报告的)。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
其体内容详见公司同日按第于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(江苏艾森半导体材料股份有限公司关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告的。)。
本议来已经董事会审计委员会时《五董事奉权。
(五审议通过了(关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案)
董事会认为,根据(公司法》证券法》(国有企业、上市公司选聘会计师事务所覆行监督职责情况的报告的议案)
董事会员会对参计师事务所有保护等的报告,公司董事会同意通过(关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责任告》。
其体内答详见公司同日按第于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(江苏艾森半导体材料股份有限公司审计委员会对公司指定董事人会相议通过。人主董事务员是有关系,以来还是董事会审计委员会和议通过,关键,20重请自己的基本关系,20重请自己的证金事以有公司。20章事我表,20章或过董事的报告。公董事务权。(六)审证董事的是第203 年度选取报告的议案)。
基本统以为。2023 年度建立董事的人和证案》,是体内容详见公司同日按第于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(江苏艾森半导体材料股份有限公司 2023 年度重要 2023 年度选取报告的议案)。
其体内容详见公司同日按第于上海证券交易所网站(次案)。
其实权公董事论取报告的议案》,

津贴方案的议案》。 董事会薪酬与考核委员会审议时,关联董事孙清清、黄晓刚回避表决,故本子议案直接提交董事 董事会薪酬与考核委员会申以时,大联里宇河州时,尽晚迎河已是是公公公会 会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于公司董事、监事,高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告》(公告编号: 2024-030)。 表决结果,各董事可意。0.名董事反对。0.2董事弃权。关联董事孙清清、黄晓刚、李挺回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十五)审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2023 年度薪酬发放及 2024 年度薪酬方案的议

(十五)甲以理以 J (天丁朝IA公司高級管理人员 2023 年度薪酬发放及 2024 年度薪酬方案的议案》 董事会认为。公司高级管理人员的薪酬校其在公司所任具体职务核定、薪酬由基本工资、津贴及奖金等组成、2023 年度公司高级管理人员的薪酬校其在公司所任具体职务核定、薪酬由基本工资、津贴及奖金等组成、2023 年度新制发放及 2024 年度新制方案的汉案》。 本议案已经董事会新制与核委员会审议通过,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.secom.en)的(江苏艾森半导体材料股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员包含。中区等的人员会会中以通过,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.secom.en)的(江苏艾森半导体材料股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员2024 年度新制方案的公告》(公告编号。2024-030)。表决结果:7 名董事同意。0 名董事反对。0 名董事弃权。关联董事向文胜、陈小华回避表决。(十六)申议通过了(关于公司向银行申请综合投信额度的议案)。 董事会认为:根据目前经济环境及公司经常的运体情况 结合公司 2024 年度资金使用计划的需要,同意公司向银行等金融机构申请综合控信为股份的方流额度,包括短期流动资金贷款、银行车兑汇票、保购。信用证、项目贷款等水式、上总综合贷信期限为自公司董事会审议通过了日起至下一次审订相同事项的董事会召开之日止。公司董事会同意通过《关于公司向银行申请综合控信额度的议案》。

次审议相同事项的董事会召开之日止。公司董事会同意通过《天子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(江苏艾森半导体材料股份和吸入支于公司向银行申请综合授信额度的公告)(公告编号;2024-032)。表决结果,9 名董事同意。0 名董事反对。0 名董事弃权。
表决结果,9 名董事同意。0 名董事反对。0 名董事弃权。
(十七)申议通过了《关于修订公司章彪中济思工商备案的议案》
董事会认为"为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构、根据公司法》(上市公司独立董事管理办法》(上市公司建籍管辖)第 3 号——规范运作》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及交易所证统监管规则是从上市公司宣传部行第 3 号——规范运作》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及交易所证统监管规则是从上市公司宣传部行第 3 号——规范运作》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及交易所证统宣管规办法》(上市公司宣传》后第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及交易所证统管的规范,是一个工作。2 公司董事会问意通过《关于修订公司章程》后,从中国企业的企业,是一个工作发公司功是有关手续。公司董事会同意通过《关于修订公司章程》后,机订部分内部治理制度的公告》(公告编号:2024-031)。表决结果,9 名董事同意。0 名董事反对。0 名董事弃权。本议案前需提公公司宣传及修订、制订部分内部治理制度的公告》(公告编号:2024-031)。表决结果、9 名董事同意。0 名董事反对。0 名董事弃权。在,是从市公司自律系位于《关于修订》(公司张行等)(3 查事存过、0 名董事存记。

所证券监管规则的最新规定,结合公司自身实际情况,公司同步修订公司治理制度 21 项,新制订公 1项制度。
1项制度。
1项制度。
1项制度。
1项制度。
1项制度。
1项制度。
1项制度。
1级制度,经常可能,经常是有效。
1级制度,经常是有效。
1级的关于修订《在事会议事规则》的议案。
表决结果。9名董事同意,0名董事弃权。
18.03关于修订《在事金义事规则》的议案。
表决结果。9名董事同意,0名董事京权。0名董事弃权。
18.03 关于修订《在事管理制度》的议案。
表决结果。9名董事同意,0名董事京对。0名董事弃权。
18.03 关于修订《外党保管理制度》的议案。
表决结果。9名董事同意,0名董事反对。0名董事弃权。
18.05 关于修订《外党保管理制度》的议案。
表决结果。9名董事同意。0名董事反对。0名董事弃权。
18.06 关于修订《条件发管理制度》的议案。
表决结果。9名董事同意。0名董事反对。0名董事弃权。
18.07 关于修订《条件发票制定编制的议案。
表决结果。9名董事同意。0名董事反对。0名董事弃权。
18.08 关于修订《条件发票制定编制则的议案。
表决结果。9名董事同意。0名董事反对。0名董事弃权。
18.09 关于修订《条件发管管理制度》的议案。
表决结果。9名董事同意。0名董事反对。0名董事弃权。
18.19 关于修订《金计库等分所选帮制度》的议案。
表决结果。9名董事同意。0名董事反对。0名董事弃权。
18.11 关于修订《董中、董申、高数《高数管理人员及核心技术人员持有公司股份及其变动管理制度》的实案。
表决结果。9名董事同意。0名董事反对。0名董事弃权。
18.11 关于修订《董中、基本、高数《高数管理人员及核心技术人员持有公司股份及其变动管理制度》的案。
其本结果。9名董事原对。0名董事系对。

18.10 天十部口(会订师单为州达明相股)的议案:
表决结果, 9.名董申同意, 0.名董申反对, 0.名董申弃权。
18.11 关于修订(董申, 监申, 高级管理人员及核心技术人员持有公司股份及其变动管理制度)的议案:
表决结果, 9.名董申同意, 0.名董申反对, 0.名董申弃权。
18.12 关于修订(董申会秘书工作组则)的议案;
表决结果, 9.名董申同意, 0.名董申反对, 0.名董申弃权。
18.13 关于修订(证书会经书工作组则)的议案;
表决结果, 9.名董申同意, 0.名董申反对, 0.名董申弃权。
18.14 关于修订(证书委员会议申规则)的议案;
表决结果, 9.名董申同意, 0.名董申反对, 0.名董申弃权。
18.15 关于修订(证名经会员会议申规则)的议案;
表决结果, 9.名董申同意, 0.名董申反对, 0.名董申弃权。
18.16 关于修订(证名经会员会议申规则)的议案;
表决结果, 9.名董申同意, 0.名董申反对, 0.名董申弃权。
18.17 关于修订(证名经金员会议申规则)的议案;
表决结果, 9.名董申同意, 0.名董申反对, 0.名董申弃权。
18.17 关于修订(证名经工厂组则)的议案;
表决结果, 9.名董申同意, 0.名董申反对, 0.名董申弃权。
18.18 关于修订(公经工厂组则)的议案;
表决结果, 9.名董申同意, 0.名董申反对, 0.名董申弃权。
18.19 关于修订(内部审计计制度)的议案;
表决结果, 9.名董申回意, 0.名董申反对, 0.名董申弃权。
18.20 关于修订(内部审计计制度)的议案;
表决结果, 9.名董申自意, 0.名董申反对, 0.名董申弃权。
18.21 关于修订(付资者关系管理功法)的议案;
表决结果, 9.名董申回意, 0.名董申反对, 0.名董申弃权。
18.22 关于修订(信息披露哲复与部反对, 0.名董申弃权。
18.21 关于修订(传资者关系管理功法)的议案;
表决结果, 9.名董申自意。0.名董申反对, 0.名董申弃权。
18.22 关于修订(信息披露哲复与部反对, 0.名董申弃权。
18.22 关于修订(信息披露哲复与部反对, 0.名董申弃权。
18.22 关于修订(信息披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)的(江苏艾森半导体材料股份有限公司实力, 于进一步提升公司经营管理效率, 强化市场竞争力, 增强投资者权益, 提供内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)的(江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年度"是质的议案")
本义是任金董事会战路委员会申议通过、
其本内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)的(江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年度"提后增效重回报"专项行动方案》,
表决结果, 9.名董申自意, 0.名董申京政, 10.金董申弃权。
(二十)申议通过了(关于向于公司增资的议金)
本议集任的议案,中心专员的资本支力,信证分董申公司。6.2024 年第一年发展的议案,
本议是任务董事会战路等员会申访过。2.2024 年第一年度报告的议案)
本议是任务董事会战路等员会自己通过(关于公司自定检查部口持续发展,符合公司整计成是全资本与公司自由被露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)的(江苏艾森半导体材料股份有限公司关于修订。2024 年第一年度报告的议案)
本议是任务董事公司,每年报告的议案)
本议是任务董事公司,每年报告的议案)
本以来已经董事公司的资本经济及证明的证案,并以及记述,2024 年第一年度联合的之关键,2024年第一年度报告的过来,2024年第一年度报告的过来,2024年第一年度报告的过来,2024年第一年度报告的过来,2024年第一年度报告的过来,2024年第一年度报告的过入。2024年第一年度报告的过入。2024年第一年度报告的过入。2024年第一年度报告的过入。2024年第一年度报告的过入。2024年第一年度报告的过入。2024年第一年度报告的证案,2024年第一年度报告的证案,2024年第一年度报告的证案,2024年第一位,2024年度报告的证案,2024年第一位,2024年度报告的证案,2024年第一位,2024年度报告的证案,2024年第一位,2024年度报告的证案,2024年第一位,2024年度报告的证案,2024年度报告的证案,2024年度报告的证案,2024年度报告的证案,2024年度报告的证案,2024年度报告的证案,2024年度报告的证案,2024年度报告的证案,2024年度,2024年度报告的证案,2024年度,2024年度,2024年度,2024年度,2024年度,2024年度,2024年度,2024年度,2024年度,2024年度,2024年度,2024年

会的议案》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2024-036)。 表决结果、9 名董事同意、0 名董事反对、0 名董事弃权。

<sup>寺此公</sup>古。 L苏艾森半导体材料股份有限公司董事会